同享(苏州) 电子材料科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、基本情况概述

随着公司业务规模扩张迅速,流动资金需求也有所增加,公司为满足经营发 展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000.00 万元 综合授信额度,授信方式为纯信用授信。在授信有效期内,董事会授权公司董事 长或董事长授权相关人员办理公司的融资事宜,并签署有关业务往来的法律文件。

主要融资方式:用于办理包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、 出口押汇、国内信用证、保函、商业票据贴现、商业汇票保贴、免保证金外汇衍 生品、敞口资产池、供应链融资等综合授信业务。资金用途为补充日常经营所需 流动资金。

具体授信业务品种、额度、期限和利率,以公司与银行签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2025年10月29日,该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议和第 四届董事会第二次会议审议,表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》,该 议案无需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次新增银行授信额度符合公司生产经营和业务发展需求,有助于改善公司 当前现金流量及财务状况,对促进公司业务发展、提高综合竞争力等方面具有积 极影响,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日